

# SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第15回講演会

## 15th Meeting on SiC and Related Wide Bandgap Semiconductors

主催: 応用物理学会「SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会」

後援: 高崎市

場所: 高崎シティギャラリー

---

### プログラム (Technical Program)

---

#### 11月9日(木)(November 9, Thursday)

10:20-10:30 開会の辞 (Opening Address)  
代表幹事 奥村 元 (産業技術総合研究所)

#### I プレナリー (Plenary) 10:30~12:00

10:30 I -1 NEDO プロジェクト「パワーエレクトロニクスインバータ基盤技術開発」が目指すもの  
【招待講演】 Prospects of NEDO Project "Basic R&D of Power Electronics Inverter"  
荒井和雄 (産業技術総合研究所 パワーエレクトロニクス研究センター)

11:00 I -2 ハイブリッド車とパワーデバイス  
【招待講演】 Power Devices for Hybrid Vehicles  
石子雅康 ((株)豊田中央研究所)

11:30 I -3 原子力発電プラントにおける耐放射線性半導体回路のニーズ  
【招待講演】 Needs of Radiation & Heat Proof Chip on Nuclear Power Plants  
日比宏基 (三菱重工業 原子力技術センター 炉心技術部)

12:00-13:30 昼食 (Lunch)

#### ポスターセッション (Poster Session) 13:30~16:00

前半 13:30~14:45 奇数番号の論文(P-1,P-3,P-5,,,P-83)  
後半 14:45~16:00 偶数番号の論文(P-2,P-4,P-6,,,P-82)

16:00-16:15 コーヒーブレイク (Coffee Break)

#### II SiC 結晶成長 (SiC Growth) 16:15~17:45

16:15 II -1 SiC 結晶成長 ~現状と展望~  
【キーノート】 SiC Crystal Growth ~Current Status and Perspectives~  
土田秀一 ((財)電力中央研究所 材料科学研究所)

- 16:45 II-2 From Macroscopic to Microscopic: Challenging Topics of Defect Reduction in Today's Sublimation Grown SiC Bulk Crystals  
Michael Rasp, Thomas Straubinger, Erwin Schmitt, Arnd-Dietrich Weber  
(SiCrystal AG)
- 17:15 II-3 Si-C-Ti 三元系溶液から得られた 6H-SiC 単結晶の XRD 評価  
【P-9】 XRD Characterization of the 6H-SiC Single Crystal Grown from Si-C-Ti Ternary Solution  
矢代将齊、楠一彦、亀井一人、八内昭博（住友金属工業株式会社 総合技術研究所）
- 17:30 II-4 高速成長した 4H-SiC エピ膜中のトラップ密度および基底面転位密度の低減  
【P-5】 Low Trap Concentration and Low Basal-Plane Dislocation Density in 4H-SiC Epilayers Grown at High Growth Rate  
堀勉<sup>1,2</sup>、旦野克典<sup>1</sup>、木本恒暢<sup>1</sup>（<sup>1</sup> 京都大学 工学研究科 電子工学専攻、<sup>2</sup>(株)NEOMAX）

---

18:30 ~ 20:30 懇親会 (Reception)  
(ホテルメトロポリタン高崎 6F 丹頂)

11月10日(金)(November 10, Friday)III 窒化物結晶・評価・プロセス (Crystal Growth and Characterization of Nitrides) 9:15~10:15

9:15 III-1 III 族窒化物半導体結晶の最近の進展

【キーノート】 Recent Progress on Group-III Nitride Semiconductor Materials  
碓井彰（古河機械金属株式会社 研究開発本部）

9:45 III-2 極紫外ラマン、フォトルミネッセンス分光法による GaN/AlN/4H-SiC(0001)へテロ構造の歪み、結晶性評価

Characterization of Strain and Crystallinity in GaN/AlN/4H-SiC(0001)  
Heterostructures by Raman and PL Spectroscopies北村寿朗<sup>1</sup>、中島信一<sup>1</sup>、三谷武志<sup>1</sup>、中村奈由波<sup>1,3</sup>、古田啓<sup>2</sup>、奥村元<sup>1</sup>（<sup>1</sup>産業技術総合研究所パワーエレクトロニクス研究センター、<sup>2</sup>素子協、<sup>3</sup>日大大学院基礎科学研究科）

10:00 III-3 触媒基準エッティング法による GaN の加工

【P-53】 Catalyst-Referred Etching of GaN

村田順二<sup>1</sup>、久保田章亜<sup>2</sup>、八木圭太<sup>1</sup>、佐野泰久<sup>1</sup>、原英之<sup>1</sup>、有馬健太<sup>1</sup>、  
三村秀和<sup>1</sup>、山内和人<sup>1</sup>（<sup>1</sup>大阪大学大学院工学研究科、<sup>2</sup>熊本大学大学院自然科学  
研究科）

10:15-10:25 休憩 (Break)

IV SiC 結晶評価 (Characterization of SiC) 10:25~11:40

10:25 IV-1 &lt;個別討論会報告&gt;

【キーノート】 SiC 基板材料の非破壊・高速・全体評価の重要性 —SiC 個別討論会の議論をふ  
まえて—Importance of Rapid, Nondestructive and Whole Characterization of SiC  
Substrates

播磨弘（京都工芸繊維大学）

10:55 IV-2 X 線 3D トポグラフィーによる SiC ダイオード中のらせん転位の解析

【P-19】 Characterization of Screw Dislocation in a SiC p-n Diode by using Novel  
Three-Dimensional X-ray Topography田森妙、田沼良平、俵武志、後藤雅秀、中村俊一、米澤喜幸、斎藤明（富士電機ア  
ドバンストekノロジー(株)）

11:10 IV-3 赤外線散乱トモグラフィーによる 6H-SiC パルク単結晶基板の非破壊 3 次元観察

【P-15】 Nondestructive Three-Dimensional Observation of 6H-SiC Bulk Single Crystal  
Wafers by Infrared Light Scattering Tomography Technique森太一郎<sup>1</sup>、Wutimakun Passapong<sup>1</sup>、宮崎尚<sup>1</sup>、岡本庸一<sup>1</sup>、守本純<sup>1</sup>、林利彦<sup>2</sup>、  
塙見弘<sup>2</sup>（<sup>1</sup>防衛大学校機能材料工学科、<sup>2</sup>(株) シクスオン）11:25 IV-4 Elimination of Z<sub>1/2</sub> and EH<sub>6/7</sub> Traps in 4H-SiC Epilayers by Carbon  
Implantation/Annealing ProcessL. Storasta、H. Tsuchida (Central Research Institute of Electric Power  
Industry)

11:40-13:00 昼 食 (Lunch)

研究奨励賞表彰式(13:00~13:10)

V SiC プロセス・加工(SiC Device Fabrication Process) 13:10~14:25

- 13:10 V-1 SiC のプロセス・加工技術の課題  
【キーノート】 Remaining Issues in SiC Process Technology  
木本恒暢 (京都大学 工学研究科 電子工学専攻)
- 13:40 V-2 触媒基準エッティング法による SiC 平坦化における代替触媒の評価  
【P-52】 Assessment of Alternative Catalysts in SiC Planarization by CAstalyst-Referred Etching  
原英之<sup>1</sup>、佐野泰久<sup>1</sup>、有馬健太<sup>1</sup>、八木圭太<sup>1</sup>、村田順二<sup>1</sup>、久保田章龜<sup>2</sup>、  
三村秀和<sup>1</sup>、山内和人<sup>1</sup> (<sup>1</sup> 大阪大学大学院工学研究科精密科学・応用物理学専攻、<sup>2</sup> 熊本大学大学院 自然科学研究科 先端機械システム講座)
- 13:55 V-3 高濃度磷イオン注入領域上の 4H SiC 熱酸化膜信頼性評価  
【P-34】 Reliability Study of Thermal Oxide on Highly Phosphorus Doped 4H SiC  
吉江徹<sup>1</sup>、内田英次<sup>1</sup>、下里淳<sup>2</sup>、先崎純寿<sup>2</sup>、福田憲司<sup>2</sup> (<sup>1</sup> 沖電気工業株式会社  
半導体 BG 研究本部デバイス研究開発部、<sup>2</sup> 独立行政法人 産業技術総合研究所パ  
ワーエレクトロニクス研究センター)
- 14:10 V-4 SiC-SBD の逆バイアス電解エッティングおよび追加溶融 KOH エッティング  
【P-42】 Reverse Biased Electrochemical Etching of SiC-SBD and Additional Molten KOH Etching  
西川恒一、前山雄介、福田祐介、清水正草、佐藤雅、岩黒弘明 (新電元工業(株)研  
究開発センター)

14:25-14:40 コーヒーブレイク (Coffee Break)

VI SiC/GaN デバイス(SiC/GaN Devices) 14:40~16:40

- 14:40 VI-1 パワーエレクトロニクスにおける WBG 半導体デバイスへの期待  
【キーノート】 Expectation to the WBG Semiconductor Devices for Power Electronics  
上野勝典 (富士電機アドバンストテクノロジー(株)電子デバイス技術センター)
- 15:10 VI-2 High Temperature Direct Double Side Cooled SiC Inverter Module for Hybrid  
【招待講演】 Electric Vehicle Application  
Rajesh Kumar Malhan<sup>1</sup>、Takeo Yamamoto<sup>1</sup>、Yuuichi Takeuchi<sup>1</sup>、Cyril Buttay<sup>2</sup>、  
C. Mark Johnson<sup>2</sup>、Jeremy Rashid<sup>3</sup>、Florin Udrea<sup>3</sup>、Gehan A. J. Amarasinghe<sup>3</sup>、  
Peter Tapin<sup>4</sup>、Nick Wright<sup>4</sup>、Peter Ireland<sup>5</sup> (<sup>1</sup>DENSO CORPORATION,  
Research Laboratories、<sup>2</sup>Department of Electronic and Electrical Engineering,  
University of Sheffield、<sup>3</sup>Department of Engineering, University of Cambridge、  
<sup>4</sup>Department of Electrical and Electronic Engineering、<sup>5</sup>Department of  
Engineering Science, University of Oxford)

- 15:40 VI-3 窒化ガリウム系材料の表面制御とデバイス応用  
【招待講演】 Surface Control of GaN-based Materials for Electron Device Application  
橋詰保（北海道大学・量子集積エレクトロニクス研究センター）
- 16:10 VI-4 1.35kV, 8.2mΩ-cm<sup>2</sup> (000-1) 4H-SiC DIMOSFET の試作  
【P-70】 Fabrication of 1.35kV, 8.2mohm-cm<sup>2</sup> (000-1) DIMOSFETs  
小杉亮治、佐久間由貴、福田憲司、荒井和雄（産業技術総合研究所 パワーエレクトロニクス研究センター）
- 16:25 VI-5 薄層 AlGaN 構造を用いたノーマリオフ GaN パワーデバイス  
【P-83】 Normally-Off GaN Power Devices with a Thin-AlGaN-Layer Structure  
池田成明、李江、加藤禎宏、増田満、吉田清輝（古河電気工業(株)横浜研究所）
- 16:40-16:50 閉会の辞 (Closing Remarks)  
代表幹事 奥村 元（産業技術総合研究所）

**ポスター発表(Contributed papers for Poster)**

\* 講演者の前に記載の▲は奨励賞申請講演であることを示す

**SiC 結晶・エピ成長**

**P-1 Hot-Mesh CVD 法を用いた SiCOI 構造基板形成とその応用**

Fabrication of SiCOI Structure Substrates using Hot-Mesh CVD and its Applications

▲三浦仁嗣<sup>1</sup>、安部和貴<sup>1</sup>、黒木雄一郎<sup>1</sup>、宮口孝司<sup>2</sup>、佐藤健<sup>2</sup>、安井寛治<sup>1</sup>、高田雅介<sup>1</sup>、赤羽正志<sup>1</sup>（<sup>1</sup>長岡技術科学大学 電気系、<sup>2</sup>新潟県工業技術総合研究所レーザー・ナノテク研究室）

**P-2 高濃度窒素ドープによって発生する SiC バルク単結晶中の結晶欠陥**

Defect and Growth Analysis of SiC Bulk Single Crystal with High Nitrogen Doping

加藤智久、三浦知則、西澤伸一、荒井和雄（産総研）

**P-3 4H-SiC 高速ホモエピタキシャル成長における基板のオフ角の影響**

Effect of the Off-Cut Angle of Substrates on 4H-SiC High-rate Homoepitaxial Growth

石田夕起<sup>1</sup>、高橋徹夫<sup>1</sup>、奥村元<sup>1</sup>、荒井和雄<sup>1</sup>、吉田貞史<sup>2</sup>（<sup>1</sup>産業技術総合研究所、<sup>2</sup>埼玉大学工学部）

**P-4 温度勾配制御可能な SiC エピ炉における高速・厚膜成長**

Development of High Growth Rate SiC Epi-Reactor with Controlled Thermal Gradient

▲伊藤雅彦、リュタウラス ストラスタ、土田秀一（電力中央研究所）

**P-5 高速成長した 4H-SiC エピ膜中のトラップ密度および基底面転位密度の低減**

Low Trap Concentration and Low Basal-Plane Dislocation Density in 4H-SiC Epilayers Grown at High Growth Rate

▲堀勉<sup>1,2</sup>、旦野克典<sup>1</sup>、木本恒暢<sup>1</sup>（<sup>1</sup>京都大学 工学研究科 電子工学専攻、<sup>2</sup>(株)NEOMAX）

**P-6 SiC エピ膜中の転位形成**

Formation of Dislocation in SiC Epitaxial Layer

内藤正美、恩田正一（(株)デンソー基礎研究所）

**P-7 プラズマ CVD および Cat-CVD による SiC の低温成長と光学的性質**

SiC Film Growth by Plasma and Catalytic CVD and Optical Properties of the Films

金子聰<sup>1</sup>、泰井まどか<sup>1</sup>、菅俊介<sup>1</sup>、長田英樹<sup>1</sup>、宮川宣明<sup>2</sup>（<sup>1</sup>東理大・理、<sup>2</sup>諏訪東理大・機械システム）

**P-8 水素エッティングにおけるシラン添加の効果**

Effect of Additional Silane on In-Site H<sub>2</sub> Etching Prior to 4H-SiC Homoepitaxial Growth

児島一聰、奥村元、荒井和雄（(独)産業技術総合研究所 パワーエレクトロニクス研究センター）

**P-9 Si-C-Ti 三元系溶液から得られた 6H-SiC 単結晶の XRD 評価**

XRD Characterization of the 6H-SiC Single Crystal Grown from Si-C-Ti Ternary Solution

矢代将齊、楠一彦、亀井一人、八内昭博（住友金属工業株式会社 総合技術研究所）

- P-10 Si(001)基板上での高密度 SiC, Ge ナノドットの形成  
High Density SiC, Ge Nano Dots Formation on Si(001) Substrate  
▲荻原智明、金丸哲史、安井寛治、赤羽正志、高田雅介（長岡技術科学大学 工学部電気系）
- SiC 結晶評価
- P-11 塩素と酸素の熱エッチングを使った SiC 結晶性評価と素子プロセスへの応用  
Evaluation of Crystallinity and Application to Device Process in SiC by Cl<sub>2</sub>-O<sub>2</sub> Thermal Etching  
畠山智亮、武並進、清水智也、矢野裕司、浦岡行治、冬木隆（奈良先端大・物質創成）
- P-12 半絶縁性 6H-SiC 単結晶基板の光焦電(PPE)法による熱的異方性評価  
Thermal Anisotropy of Semi-insulating 6H-SiC Single Crystal Wafers Examined by Photopyroelectric (PPE) Method  
▲Passapong Wutimakun<sup>1</sup>、森太一郎<sup>1</sup>、宮崎尚<sup>1</sup>、岡本庸一<sup>1</sup>、守本純<sup>1</sup>、林利彦<sup>2</sup>、塙見弘<sup>2</sup>  
(<sup>1</sup>防衛大学機能材料工学科、<sup>2</sup>(株)シクスオン)
- P-13 光学的表面検査装置(Candela-CS10)による SiC ウエハの表面観察  
Surface Inspection of Silicon Carbide Wafers using the Candela CS 10 Optical Surface Analyzer  
畠山哲夫<sup>1</sup>、鈴木拓馬<sup>1</sup>、一ノ関共一<sup>1</sup>、福田憲司<sup>2</sup>、樋口登<sup>1</sup>、四戸孝<sup>1</sup>、荒井和雄<sup>2</sup>（<sup>1</sup>(財)新機能素子研究開発協会 次世代インバータ基盤技術研究所、<sup>2</sup>産業技術総合研究所 パワーエレクトロニクス研究センター）
- P-14 高分解能トポグラフィによる 4H-SiC 結晶欠陥の評価  
Evaluation of Dislocations in 4H-SiC by High-Resolution Topography  
鎌田功穂、長野正裕、土田秀一（電力中央研究所）
- P-15 赤外線散乱トモグラフィーによる 6H-SiC バルク単結晶基板の非破壊 3 次元観察  
Nondestructive Three-Dimensional Observation of 6H-SiC Bulk Single Crystal Wafers by Infrared Light Scattering Tomography Technique  
▲森太一郎<sup>1</sup>、Wutimakun Passapong<sup>1</sup>、宮崎尚<sup>1</sup>、岡本庸一<sup>1</sup>、守本純<sup>1</sup>、林利彦<sup>2</sup>、塙見弘<sup>2</sup>  
(<sup>1</sup>防衛大学校機能材料工学科、<sup>2</sup>(株)シクスオン)
- P-16 深紫外光励起室温 PL マッピングによる 4H-SiC バルク基板内積層欠陥の非破壊評価  
Nondestructive Analysis of Stacking Faults in 4H-SiC Bulk Wafers by Room-Temperature PL Mapping under Deep UV Excitation  
▲星乃紀博<sup>1,2</sup>、田島道夫<sup>1,2</sup>、西口太郎<sup>3</sup>、林利彦<sup>3</sup>、木下博之<sup>3</sup>、塙見弘<sup>3</sup>（<sup>1</sup>JAXA 宇宙研、<sup>2</sup>東大院工、<sup>3</sup>(株)シクスオン）
- P-17 エレクトロルミネッセンスによる 4H-SiC pin ダイオードの積層欠陥の評価  
Evaluation of the Stacking Fault in 4H-SiC pin Diode by Electroluminescence Images  
▲石井竜介<sup>1,2</sup>、中山浩二<sup>1</sup>、菅原良孝<sup>1</sup>、三柳俊之<sup>2</sup>、鎌田功穂<sup>2</sup>、土田秀一<sup>2</sup>（<sup>1</sup>関西電力株式会社、<sup>2</sup>電力中央研究所）
- P-18 UV-LED, 2D-CCD を用いた 4H-SiC の転位・積層欠陥の PL マッピング観察  
PL Mapping of Dislocations and Stacking Faults in 4H-SiC by using UV-LED and 2D-CCD  
長野正裕、鎌田功穂、土田秀一（電力中央研究所）

- P-19 X線3DトポグラフィーによるSiCダイオード中のらせん転位の解析  
 Characterization of Screw Dislocation in a SiC p-n Diode by using Novel Three-Dimensional X-ray Topography  
 田森妙、田沼良平、俵武志、後藤雅秀、中村俊一、米澤喜幸、齊藤明（富士電機アドバンストテクノロジー(株)）
- P-20 テラヘルツ分光法によるSiCエピタキシャル成長膜のキャリヤ濃度、移動度、膜厚の同時評価  
 Simultaneous Determination of the Carrier Concentration, Mobility and Thickness of SiC Homo-Epitayers using Terahertz Reflectance Spectroscopy  
 大石慎吾、土方泰斗、矢口裕之、吉田貞史（埼玉大学 大学院 理工学研究科 数理電子情報専攻）
- P-21 p型SiCの過剰キャリア減衰曲線の解析による少数キャリアトラップ準位の評価  
 Estimation of the Energy Level of a Minority Carrier Trap by Analysis of Excess Carrier Decay Curves in p-type SiC  
 ▲河合政彦、加藤正史、市村正也（名古屋工業大学 大学院 工学研究科 機能工学専攻）
- P-22 n型4H-SiC成長層における深い準位の評価と起源の考察  
 Investigation of Deep Levels in n-type 4H-SiC and Their Origin  
 ▲旦野克典<sup>1</sup>、堀勉<sup>1,2</sup>、木本恒暢<sup>1</sup>（<sup>1</sup>京都大学 工学研究科 電子工学専攻、<sup>2</sup>(株)NEOMAX）
- P-23 Elimination of Z<sub>1/2</sub> and EH<sub>6/7</sub> Traps in 4H-SiC Epilayers by Carbon Implantation/Annealing Process  
 ▲L. Storasta, H. Tsuchida (Central Research Institute of Electric Power Industry)
- P-24 転位近傍におけるラマン散乱分光法によるSiCの応力評価  
 Study of Stress Distribution Near Dislocations in SiC by Raman Scattering  
 松岡大介<sup>1</sup>、高橋健二<sup>1</sup>、木曾田賢治<sup>2</sup>、播磨弘<sup>1</sup>（<sup>1</sup>京都工芸繊維大学 大学院 工芸科学研究科、<sup>2</sup>和歌山大学 教育学部）
- P-25 p型4H-SiCの耐放射線性  
 Radiation Hardness of p-type 4H-SiC  
 松浦秀治<sup>1</sup>、養原伸正<sup>1</sup>、高橋美雪<sup>1</sup>、大島武<sup>2</sup>、伊藤久義<sup>2</sup>（<sup>1</sup>大阪電気通信大学 工学部 電子工学科、<sup>2</sup>日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門）
- SiCプロセス・加工
- P-26 分光エリプソメータによるSiO<sub>2</sub>/SiC界面の光学的評価 —複数の入射角による測定—  
 Optical Characterization of SiO<sub>2</sub>/SiC Interfaces by Spectroscopic Ellipsometer  
 —Measurements using Multiple Angles of Incidence—  
 嶋木亮一、橋本英樹、土方泰斗、矢口裕之、吉田貞史（埼玉大学 大学院 理工学研究科 数理電子情報専攻）
- P-27 分光エリプソメータによるSiO<sub>2</sub>/SiC界面の光学的評価 —酸化法、面方位依存性—  
 Characterization of SiO<sub>2</sub>/SiC Interfaces using Spectroscopic Ellipsometer —Dependence on Oxidation Methods and Surface Orientation—  
 橋本英樹、嶋木亮一、土方泰斗、矢口裕之、吉田貞史（埼玉大学 工学部 電気電子システム工学科）

- P-28 In-situ 分光エリプソメータによる SiC 酸化速度の酸素分圧依存性測定  
Oxygen-Partial-Pressure Dependence of SiC Oxidation Rate Studied by In-situ Spectroscopic Ellipsometer  
山本健史、土方泰斗、矢口裕之、吉田貞史（埼玉大学 大学院理工学研究科 電気電子システム領域）
- P-29 シミュレーションによるアモルファス  $\text{SiO}_2/\text{SiC}$  界面の生成～第一原理分子動力学計算～  
Generation of Amorphous  $\text{SiO}_2/\text{SiC}$  Interface by the Simulation: First-Principles Molecular Dynamics  
宮下敦巳<sup>1</sup>、大沼敏治<sup>2</sup>、岩沢美佐子<sup>2</sup>、土田秀一<sup>2</sup>、吉川正人<sup>1</sup>（<sup>1</sup>日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門、<sup>2</sup>電力中央研究所 材料科学研究所）
- P-30  $\text{SiO}_2/4\text{H-SiC}(0001)$  界面における熱酸化過程の第一原理分子動力学シミュレーション—炭素クラスターの形成—  
First-Principles Molecular Dynamics Study of  $\text{SiO}_2/4\text{H-SiC}(0001)$  Interface Oxidation Process: Formation of Carbon Cluster  
大沼敏治<sup>1</sup>、宮下敦巳<sup>2</sup>、岩沢美佐子<sup>1</sup>、吉川正人<sup>2</sup>、土田秀一<sup>1</sup>（<sup>1</sup>電力中央研究所 材料科学研究所、<sup>2</sup>日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門）
- P-31 SiC 基板表面処理と  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiC}$  MOS キャパシタの界面特性  
Surface Treatment of SiC Substrate and the Interface Properties of  $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiC}$  MOS Capacitors  
畠山智裕<sup>1</sup>、日野史郎<sup>1</sup>、徳光永輔<sup>1</sup>、三浦成久<sup>2</sup>、大森達夫<sup>2</sup>（<sup>1</sup>東工大 精研、<sup>2</sup>三菱電機(株)）
- P-32 窒素イオン注入によりアモルファス化された 4H-SiC を用いた MOS キャパシタの作製  
Fabrication of MOS Capacitors using 4H-SiC Preamorphized by Nitrogen Ion Implantation  
土方泰斗<sup>1</sup>、矢口裕之<sup>1</sup>、吉田貞史<sup>1</sup>、F.Moscatelli<sup>2</sup>、A. Poggi<sup>2</sup>、S. Solmi<sup>2</sup>、R. Nipoti<sup>2</sup>（<sup>1</sup>埼玉大院理工研、<sup>2</sup>CNR-IMM (Italy)）
- P-33 低濃度窒素イオン注入層上に形成された SiC 酸化膜信頼性  
Reliability of Thermal Oxide Grown on n-type 4H-SiC Wafer Implanted with Low Nitrogen Concentration  
先崎純寿、下里淳、原田信介、福田憲司（独立行政法人 産業技術総合研究所 パワーエレクトロニクス研究センター）
- P-34 高濃度磷イオン注入領域上の 4H SiC 热酸化膜信頼性評価  
Reliability Study of Thermal Oxide on Highly Phosphorus Doped 4H SiC  
吉江徹<sup>1</sup>、内田英次<sup>1</sup>、下里淳<sup>2</sup>、先崎純寿<sup>2</sup>、福田憲司<sup>2</sup>（<sup>1</sup>沖電気工業株式会社 半導体 BG 研究本部デバイス研究開発部、<sup>2</sup>独立行政法人 産業技術総合研究所パワーエレクトロニクス研究センター）
- P-35 ONO ゲート絶縁膜の遮断状態信頼性  
Reliability Study on ONO Gate Dielectric on 4H-SiC in Blocking State  
谷本智、山上滋春、田中秀明、林哲也、星正勝、篠原俊朗（日産自動車(株)総合研究所）

- P-36 カーボンキャップによる高温活性化熱処理  
High Temperature Activation using Carbon Cap  
中村広希、三好好広、山本剛、榎原利夫（株式会社 デンソー 基礎研究所）
- P-37 Nイオン注入4H-SiC(0001)における欠陥の消滅と電気的活性化過程  
Annealing Behavior of Implanted N and Defects in 4H-SiC  
鈴木知之、宮川晋悟、工藤尚宏、佐藤政孝（法政大学イオンビーム工学研究所）
- P-38 Isochronal Annealing Study of Deep levels in Hydrogen Implanted p-type 4H-SiC  
G. Alfieri, T. Kimoto (Department of Electronic Science and Engineering, Kyoto University)
- P-39 Alイオン注入により形成した4H-SiC p<sup>+</sup>n接合ダイオードのアニール特性  
Annealing Characteristics of 4H-SiC p<sup>+</sup>n Junction Diode Fabricated by Al Ion Implantation  
宮川晋悟、永田翔平、佐藤政孝、江上明宏、沼尻憲二、熊谷晃、柴垣真果（法政大学イオンビーム工学研究所、キヤノンアネルバ株式会社）
- P-40 Nイオン注入層上に形成したショットキー電極の評価  
Evaluation of Schottky Contact Formed on N Ion Implanted Layer at Low Dose  
松尾浩、佐藤政孝（法政大学イオンビーム工学研究所）
- P-41 犠牲酸化を用いた高温処理後のSiC表面劣化の除去によるSBD電気特性の向上  
Improvement of SBD Electronic Characteristics by Processing of Sacrificial Oxidation to Remove the Degraded Layer from SiC Surface after High Temperature Annealing  
木下明将、西孝、八尾勉、福田憲司（産業技術総合研究所 パワーエレクトロニクス研究センター）
- P-42 SiC-SBDの逆バイアス電解エッチングおよび追加溶融KOHエッチング  
Reverse Biased Electrochemical Etching of SiC-SBD and Additional Molten KOH Etching  
西川恒一、前山雄介、福田祐介、清水正章、佐藤雅、岩黒弘明（新電元工業(株)研究開発センター）
- P-43 SiC単結晶ウェハの高速高品位研磨  
High Throughput SiC Wafer Polishing with Good Surface Morphology  
加藤智久、八朔月英二、和田桂典、谷口寛芳、西澤伸一、荒井和雄（産総研）
- P-44 SiC基板用研磨材の開発と試作  
Preparation of Device Ready SiC Surface with a Novel Abrasive  
廣瀬健次<sup>1</sup>、堀田和利<sup>1,2</sup>、田中弥生<sup>3</sup>、安部功二<sup>4</sup>、河田研治<sup>2</sup>、江龍修<sup>1</sup>（<sup>1</sup>名古屋工業大学大学院産業戦略工学専攻、<sup>2</sup>株式会社フジミインコーポレーテッド研究開発センター、<sup>3</sup>名古屋工業大学電気情報工学科、<sup>4</sup>名古屋工業大学大学院機能工学専攻）
- P-45 SiC表面上のエピタキシャルSiO/SiN超構造の作製  
Epitaxial SiO/SiN Superstructures on SiC Surfaces  
田中悟<sup>2</sup>、藤井政弘<sup>1</sup>、白澤徹郎<sup>2</sup>、林賢二郎<sup>2</sup>、水野清義<sup>2</sup>、榎原浩<sup>2</sup>（<sup>1</sup>北海道大学電子科学研究所、<sup>2</sup>九州大学大学院総合理工学研究院）

- P-46 三フッ化塩素ガスによる 4H-SiC エッチング  
4H Silicon Carbide Etching using Chlorine Trifluoride Gas  
勝見雄介<sup>1</sup>、羽深等<sup>1</sup>、深井靖<sup>2</sup>、深江功也<sup>2</sup>、加藤智久<sup>3</sup>、奥村元<sup>3</sup>、荒井和雄<sup>3</sup>（<sup>1</sup>横国大院工、<sup>2</sup>関東電化、<sup>3</sup>産総研）
- P-47 高密度プラズマエッチング装置による高速 SiC エッチング  
High-Rate SiC Etching with High-Density Plasma  
藤井圭、中谷郁祥 ((株)レスカ 生産事業本部)
- P-48 SiO<sub>2</sub> マスクを用いた 4H-SiC の高選択比ドライエッチング  
High Selective Ratio Dry Etching of 4H-SiC using SiO<sub>2</sub> Mask  
河田泰之、中村俊一、田森妙、米澤喜幸（富士電機アドバンストテクノロジー(株) 電子デバイス技術センター 半導体研究所）
- P-49 湿式プロセスにより得られた超平坦 4H-SiC(0001)実用表面の原子構造解析  
Atomic-Scale Analysis of 4H-SiC (0001) Surface after Wet-Chemical Preparations.  
岡本亮太<sup>1</sup>、有馬健太<sup>2</sup>、佐野泰久<sup>2</sup>、原英之<sup>2</sup>、石田剛志<sup>1</sup>、八木圭太<sup>2</sup>、久保田章亀<sup>3</sup>、  
三村秀和<sup>2</sup>、山内和人<sup>2</sup>（<sup>1</sup>大阪大学大学院工学研究科附属超精密科学研究センター、<sup>2</sup>大阪大学大学院工学研究科精密科学・応用物理学専攻、<sup>3</sup>熊本大学工学部知能生産システム工学科）
- P-50 超短パルスレーザーを用いた SiC のマイクロ/ナノ加工  
Micro/Nano-Processing of SiC using a Ultra-Short Pulsed Laser Beam  
▲富田卓朗、熊井亮太、木下敬太、松尾繁樹、橋本修一（徳島大学大学院工学研究科エコシステム工学専攻）
- P-51 ナイトライド成長に向けた高温水素ガスエッチングによる 6H-SiC(0001)ジャスト基板のステップ構造制御  
Control of Step Structure of 6H-SiC (0001) On-axis Substrates for Nitride Heteroepitaxy  
▲奥村宏典<sup>1</sup>、須田淳<sup>2</sup>、木本恒暢<sup>2</sup>、吉岡善光<sup>3</sup>、佐々木信<sup>3</sup>、西口太郎<sup>3</sup>、池田敬一<sup>3</sup>、  
林利彦<sup>3</sup>、木下博之<sup>3</sup>（<sup>1</sup>京都大学工学部電気電子工学科、<sup>2</sup>京都大学大学院工学研究科電子工学専攻<sup>3</sup>株式会社シクスオン）
- P-52 触媒基準エッチング法による SiC 平坦化における代替触媒の評価  
Assessment of Alternative Catalysts in SiC Planarization by Catalyst-Referred Etching  
原英之<sup>1</sup>、佐野泰久<sup>1</sup>、有馬健太<sup>1</sup>、八木圭太<sup>1</sup>、村田順二<sup>1</sup>、久保田章亀<sup>2</sup>、三村秀和<sup>1</sup>、  
山内和人<sup>1</sup>（<sup>1</sup>大阪大学大学院工学研究科精密科学・応用物理学専攻、<sup>2</sup>熊本大学大学院自然科学研究科 先端機械システム講座）
- 窒化物・酸化物半導体結晶成長・評価・プロセス
- P-53 触媒基準エッチング法による GaN の加工  
Catalyst-Referred Etching of GaN  
▲村田順二<sup>1</sup>、久保田章亀<sup>2</sup>、八木圭太<sup>1</sup>、佐野泰久<sup>1</sup>、原英之<sup>1</sup>、有馬健太<sup>1</sup>、三村秀和<sup>1</sup>、  
山内和人<sup>1</sup>（<sup>1</sup>大阪大学大学院工学研究科、<sup>2</sup>熊本大学大学院自然科学研究科）

- P-54 研磨による GaN 超平坦化機構の解明  
Mechanism of Making to Super-Flatness of GaN by Polishing  
坂本浩二<sup>1</sup>、安部功二<sup>1</sup>、江龍修<sup>2</sup>（<sup>1</sup>名古屋工業大学 機能工学専攻、<sup>2</sup>産業戦略工学専攻）
- P-55 p-GaN に対する ICP エッティングダメージの電気的評価  
Electrical Characterization of ICP Etching Damage on p-GaN  
三鴨一輝<sup>1</sup>、加藤正史<sup>1</sup>、市村正也<sup>1</sup>、兼近将一<sup>2</sup>、石黒修<sup>2</sup>、加地徹<sup>2</sup>（<sup>1</sup>名古屋工業大学、<sup>2</sup>豊田中央研究所）
- P-56 Hot-mesh CVD 法による SiC/Si 基板上への AlN バッファー層を用いての GaN 膜成長  
The Growth of GaN Films on SiC/Si Substrates using AlN Buffer Layer by Hot-Mesh CVD  
▲深田祐介<sup>1</sup>、田村和之<sup>1</sup>、黒木雄一郎<sup>1</sup>、末光眞希<sup>2</sup>、伊藤隆<sup>2</sup>、成田克<sup>3</sup>、遠藤哲郎<sup>4</sup>、中澤日出樹<sup>5</sup>、高田雅介<sup>1</sup>、安井寛治<sup>1</sup>、赤羽正志<sup>1</sup>（<sup>1</sup>長岡技術科学大学、<sup>2</sup>東北大学学際科学国際高等研究センター、<sup>3</sup>九州工業大学工学部、<sup>4</sup>東北大学電気通信研究所、<sup>5</sup>弘前大学理工学部）
- P-57 高分解能 X 線回折装置による結晶性評価と極性評価技法の検討  
稻葉克彦（株式会社リガク X 線研究所）
- P-58 過剰キャリアライフタイム測定による undoped GaN のプラズマエッティングダメージとアニール効果の評価  
Characterization of Plasma Etching Damage and Annealing Effects on Undoped GaN by Excess Carrier Lifetime Measurements  
福島圭亮<sup>1</sup>、加藤正史<sup>1</sup>、市村正也<sup>1</sup>、兼近将一<sup>2</sup>、石黒修<sup>2</sup>、加地徹<sup>2</sup>（<sup>1</sup>名古屋工業大学、<sup>2</sup>豊田中央研究所）
- P-59 極紫外ラマン、蛍光分光法による GaN/AlN/4H-SiC(0001)ヘテロ構造の歪み、結晶性評価  
Characterization of Strain and Crystallinity in GaN/AlN/4H-SiC(0001) Heterostructures by Raman and PL Spectroscopies  
▲北村寿朗<sup>1</sup>、中島信一<sup>1</sup>、三谷武志<sup>1</sup>、中村奈由波<sup>1,3</sup>、古田啓<sup>2</sup>、奥村元<sup>1</sup>（<sup>1</sup>産業技術総合研究所パワーエレクトロニクス研究センター、<sup>2</sup>素子協、<sup>3</sup>日大大学院基礎科学研究所）
- SiC デバイス
- P-60 SiC ショットキ障壁ダイオードにおける障壁高さの面内分布の影響  
Influence of Distribution of Barrier Height in SiC Schottky Barrier Diode  
大塚健一<sup>1</sup>、松野吉徳<sup>2</sup>、樽井陽一郎<sup>1</sup>、黒田研一<sup>1</sup>、杉本博司<sup>1</sup>、油谷直毅<sup>1</sup>（三菱電機<sup>1</sup>先端技術総合研究所<sup>2</sup>パワーデバイス製作所）
- P-61 4H-SiC ショットキーバリアダイオードの逆方向特性に対する in-grown 積層欠陥の影響  
The Influence of In-Grown Stacking Faults on the Reverse Current-Voltage Characteristics of 4H-SiC Schottky Barrier Diodes  
原田真、並川靖生（住友電気工業(株)・半導体技術研究所）

- P-62 埋め込み層をもつ 4H-SiC ショットキーバリアダイオード(Super-SBD)における低損失化への設計指針とその実証  
Design and Fabrication of 4H-SiC Floating Junction Schottky Barrier Diodes (Super-SBDs) for Low Loss Devices  
太田千春<sup>1</sup>、西尾譲司<sup>1</sup>、畠山哲夫<sup>1</sup>、四戸孝<sup>1</sup>、児島一聰<sup>2</sup>、西澤伸一<sup>2</sup>、大橋弘通<sup>2</sup> (<sup>1</sup>(株)東芝研究開発センター<sup>2</sup>、(独)産業技術総合研究所 パワーエレクトロニクス研究センター)
- P-63 ガードリング構造を持つ 600V 100A 4H-SiC ジャンクションバリアショットキダイオード  
600 V 100 A 4H-SiC Junction Barrier Schottky Diode with Guard Rings Termination  
山本剛、遠藤剛、加藤信之、中村広希、榎原利夫 (株式会社デンソー 基礎研究所)
- P-64 4H-SiC 上 PiN ダイオードの順方向不良特性と欠陥との関連 — KOH エッチングと通電劣化現象を利用した解析  
Investigation of Defects Related to the Irregular Forward Current Conduction of the PiN Diodes on 4H-SiC  
大柳孝純 ((株)日立製作所中央研究所)
- P-65 12MeV-Au イオン照射による 6H-SiC n<sup>+</sup>p ダイオードの電荷収集  
Charge Collection from 6H-SiC n<sup>+</sup>p Diodes Irradiated with 12MeV-Au Ions  
岩本直也<sup>1,2</sup>、大島武<sup>2</sup>、佐藤隆博<sup>2</sup>、及川将一<sup>2</sup>、小野田忍<sup>2</sup>、菱木繁臣<sup>2</sup>、平尾敏雄<sup>2</sup>、神谷富裕<sup>2</sup>、横山拓郎<sup>3</sup>、坂本愛理<sup>3</sup>、田中礼三郎<sup>3</sup>、中野逸夫<sup>3</sup>、G.ワグナー<sup>4</sup>、伊藤久義<sup>2</sup>、河野勝泰<sup>1</sup> (<sup>1</sup>電通大、<sup>2</sup>原子力機構、<sup>3</sup>岡山大、<sup>4</sup>Inst. of Crystal Growth)
- P-66 600V/2A 4H-SiC RESURF 型 JFET  
600V/2A 4H-SiC RESURF-type JFET  
藤川一洋、玉祖秀人、澤田研一、穂永美紗子、増田健良、原田真、築野孝、並川靖生 (住友電気工業(株)・半導体技術研究所)
- P-67 イオン注入によりチャネル層を形成する SiC-MESFET の設計と電気特性評価  
Design and Fabrication of Fully Ion Implanted SiC-MESFET  
片上崇治、尾形誠、小野修一、新井学 (新日本無線株式会社)
- P-68 4H-と 6H-SiC 上に作製された p チャネル MOSFET の電気特性の比較  
Comparison of Electrical Properties of p-channel MOSFETs Fabricated on 4H- and 6H-SiC  
▲岡本光央、田中美恵子、八尾勉、福田憲司 (産業技術総合研究所、パワーエレクトロニクス研究センター)
- P-69 2ゾーンダブル RESURF 構造を用いた高耐圧横型 4H-SiC MOSFET の低オン抵抗化  
High-Voltage Lateral 4H-SiC MOSFETs with Low On-Resistance by using Two-Zone Double RESURF Structure  
▲登尾正人、須田淳、木本恒暢 (京都大学工学研究科電子工学専攻)
- P-70 1.35kV, 8.2mΩ·cm<sup>2</sup> (000-1) 4H-SiC DIMOSFET の試作  
Fabrication of 1.35kV, 8.2mohm·cm<sup>2</sup> (000-1) DIMOSFETs  
小杉亮治、佐久間由貴、福田憲司、荒井和雄 (産業技術総合研究所 パワーエレクトロニクス研究センター)

- P-71 MOCVD 法により低温堆積した Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜をゲート絶縁膜に有する高移動度 4H-SiC MOSFET の作製と評価  
Characterization and Fabrication of High-Mobility 4H-SiC MOSFET with MOCVD-Deposited Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Gate Insulator  
▲日野史郎<sup>1</sup>、畠山智裕<sup>1</sup>、徳光永輔<sup>1</sup>、三浦成久<sup>2</sup>、大森達夫<sup>2</sup>（<sup>1</sup>東京工業大学精密工学研究所、<sup>2</sup>三菱電機先端技術総合研究所）
- P-72 p-channel 6H-SiC MOSFET におけるガンマ線線量率と電気特性変化の関係  
Relationship between the Dose Rate of Gamma-rays and the Electrical Characteristics of p-channel 6H-SiC MOSFETs  
菱木繁臣<sup>1</sup>、大島武<sup>1</sup>、岩本直也<sup>1,2</sup>、河野勝泰<sup>2</sup>、伊藤久義<sup>1</sup>（<sup>1</sup>日本原子力研究開発機構、<sup>2</sup>電気通信大学）
- P-73 Qualitative Analysis of  $\gamma$ -Ray Irradiation Effect on the Characteristics of P Type 6H-SiC Schottky Diodes  
U. Sudjadi<sup>1</sup>、N. Iwamoto<sup>1,2</sup>、S. Hishiki<sup>1</sup>、T. Ohshima<sup>1</sup>、K. Kawamo<sup>2</sup>（<sup>1</sup>Japan Atomic Energy Agency、<sup>2</sup>The Univ. of Electro-Communications）
- 窒化物・ダイヤモンドデバイス
- P-74 高温・高出力ダイヤモンドショットキーダイオードの研究  
Research on High-temperature, High-power Diamond Schottky Barrier Diode  
梅沢仁<sup>1</sup>、徳田規夫<sup>1</sup>、辰巳夏生<sup>2</sup>、池田和寛<sup>1</sup>、鹿田真一<sup>1</sup>（<sup>1</sup>産業技術総合研究所 ダイヤモンド研究センター、<sup>2</sup>住友電気工業株式会社 半導体研究所）
- P-75 GaN自立基板上GaN pn接合ダイオードのトラップの評価  
Characterization of Traps in GaN pn Junctions on Free-Standing GaN  
徳田豊<sup>1</sup>、松岡陽一<sup>1</sup>、上田博之<sup>2</sup>、副島成雅<sup>2</sup>、石黒修<sup>2</sup>、加地徹<sup>2</sup>（<sup>1</sup>愛知工業大学工学部電気学科、<sup>2</sup>(株)豊田中央研究所）
- P-76 GaN/SiC ヘテロ接合バイポーラトランジスタのエミッタ接合電気的特性に対するアクセプタ濃度の影響  
Impact of Acceptor Concentration on Electronic Properties of n-GaN/p-SiC Heterojunction for GaN/SiC Heterojunction Bipolar Transistor  
▲甘利浩一、須田淳、木本恒暢（京都大学大学院工学研究科電子工学専攻）
- P-77 短ゲート長 AlGaN/GaN HEMT の DC 特性  
Gate-Length Dependence of DC Characteristics in Submicron-Gate AlGaN/GaN HEMTs  
井手利英<sup>1</sup>、清水三聰<sup>1</sup>、八木修一<sup>1</sup>、稻田正樹<sup>1</sup>、朴冠錫<sup>1</sup>、矢野良樹<sup>2</sup>、阿久津仲男<sup>2</sup>、奥村元<sup>1</sup>、荒井和雄<sup>1</sup>（<sup>1</sup>産業技術総合研究所 パワーエレクトロニクス研究センター、<sup>2</sup>大陽日本酸素）

- P-78 AlN/GaN 超格子により作製した擬似 AlGaN バリア層を有する HEMT 構造の SiC 微傾斜基板上成長  
Growth of HEMT Structures using Quasi-AlGaN Alloy Barriers Made by AlN/GaN Super-Lattice on SiC Vicinal Substrates  
古田啓<sup>1</sup>、中村奈由波<sup>2,3</sup>、沈旭強<sup>2</sup>、清水三聰<sup>2</sup>、北村寿朗<sup>2</sup>、中村勝光<sup>3</sup>、奥村元<sup>2</sup>（<sup>1</sup>素子協、<sup>2</sup>産総研パワエレ、<sup>3</sup>日大院文理）
- P-79 p-GaN 埋め込み AlGaN/GaN HEMT の研究  
A Study of AlGaN/GaN HEMT with Buried p-GaN  
上田博之<sup>1</sup>、杉本雅裕<sup>2</sup>、樹神雅人<sup>1</sup>、林栄子<sup>1</sup>、石黒修<sup>1</sup>、上杉勉<sup>1</sup>、加地徹<sup>1</sup>（<sup>1</sup>(株)豊田中央研究所、<sup>2</sup>トヨタ自動車(株)）
- P-80 SiC 微傾斜基板上 AlGaN/GaN HEMT 構造の Mobility に及ぼすステップバンチングの影響  
Effects of Step-Bunchings to Mobility of AlGaN/GaN HEMT Structures Grown on SiC Vicinal Substrates  
▲中村奈由波<sup>1,3</sup>、古田啓<sup>2</sup>、北村寿朗<sup>1</sup>、沈旭強<sup>1</sup>、中村勝光<sup>3</sup>、奥村元<sup>1</sup>（<sup>1</sup>産業技術総合研究所パワーエレクトロニクス研究センター、<sup>2</sup>素子協、<sup>3</sup>日大大学院基礎科学研究科）
- P-81 多層膜 MIS 構造 AlGaN/GaN HEMT の研究  
Study of AlGaN/GaN HEMT with Multilayered MIS Structure  
八木修一<sup>1</sup>、清水三聰<sup>1</sup>、奥村元<sup>1</sup>、大橋弘通<sup>1</sup>、矢野良樹<sup>2</sup>、阿久津仲男<sup>2</sup>（<sup>1</sup>産業技術総合研究所 パワーエレクトロニクス研究センター、<sup>2</sup>大陽日酸株式会社）
- P-82 AlGaN/GaN/AlGaN チャンネルを用いた電界効果トランジスタのノーマリオフ動作  
Normally-off Operation in AlGaN/GaN/AlGaN Channel Field Effect Transistors  
清水三聰<sup>1</sup>、稻田正樹<sup>1</sup>、朴冠錫<sup>1</sup>、八木修一<sup>1</sup>、井手利英<sup>1</sup>、奥村元<sup>1</sup>、荒井和雄<sup>1</sup>、矢野良樹<sup>2</sup>、阿久津仲男<sup>2</sup>（<sup>1</sup>産業技術総合研究所パワーエレクトロニクス研究センター、<sup>2</sup>大陽日酸株式会社）
- P-83 薄層 AlGaN 構造を用いたノーマリオフ GaN パワーデバイス  
Normally-off GaN Power Devices with a Thin-AlGaN-Layer Structure  
池田成明、李江、加藤禎宏、増田満、吉田清輝（古河電気工業(株)横浜研究所）